



# SENSORES

## PARA SOLDADURA DE PRECISIÓN

SENSÓRICA |





OD200



IMX

Los sensores SICK IMX y OD200 mejoran los procesos de soldadura al aportar mayor precisión y control.

El IMX permite detectar si la pieza está colocada.

El OD200, con medición láser precisa, controla distancias, alturas y alineación de piezas antes de soldar.

El SICK SIG300 centraliza la conexión de sensores en procesos de soldadura, permitiendo integrar y monitorear datos en tiempo real para mejorar el control, la trazabilidad y la eficiencia de la producción.

Juntos ayudan a reducir errores, optimizar tiempos y asegurar una mejor calidad final.

SIG300





# IMX

## BENEFICIOS

- Menor espacio** de montaje
- Menor riesgo** de daños mecánicos
- Mayor **estabilidad y menos errores** de conmutación
- Baja** interferencia
- Múltiples** aplicaciones
- Puesta en marcha **rápida y sencilla**

## CARACTERÍSTICAS

- Formatos:** desde M8 hasta M30
- Grandes distancias de conmutación:** de 4 mm a 50 mm
- Grado de protección:** IP68
- Rango de temperatura:** de -25 °C a +75 °C
- Carcasa de **latón niquelado**, superficie **activa de plástico**
- Asistente de **ajuste visual**
- Resistente** a aceites y lubricantes refrigerantes
- Distancias de conmutación **4 veces mayores**

# OD200



## BENEFICIOS

**Medición estable**  
independiente del objeto

Fiable en **superficies difíciles**

**Alta frecuencia**, mayor productividad

Configuración **rápida e intuitiva**

Alto rendimiento, **bajo costo**

Operación estable en **baja luz**

**Integración rápida** con IO-Link

## CARACTERÍSTICAS

**Repetibilidad:** 2  $\mu\text{m}$  ... 20  $\mu\text{m}$

**Linealidad:**  $\pm$  10  $\mu\text{m}$  ... 100  $\mu\text{m}$

**Frecuencia de medición:** hasta 3 kHz

**Configuración intuitiva** mediante pantalla OLED o SOPAS ET

**Campos de medición:** de 25 mm a 160 mm

**Clase de láser 1**

**Salida analógica y digital** con interfaz IO-Link

**Robusta carcasa** en miniatura

# SIG 3000

## BENEFICIOS

Integración total de **sensores y actuadores**

**Puente entre OT y IT** (Industria 4.0)

**Mayor eficiencia y productividad**

**Puesta en marcha rápida** (plug & play)

**Reducción de tiempos de mantenimiento**



## CARACTERÍSTICAS

Arquitectura **IO-Link Master**

**Conectividad** industrial y IIoT

**Editor lógico integrado** (edge computing)

**Configuración inteligente** (IODD Interpreter)

**Diseño robusto industrial** (Protección IP67)

Interfaces **físicas**

**Backup & Restore, Diagnóstico multicanal**

**Comunicación bidireccional** con dispositivos